第105回レーザ加工学会講演会　予告プログラム

1日目　　2026年12月8日（火）　大阪大学コンベンションセンター

	会議室2		
10:00	開会の辞		
プレナリーセッション		座長：田中健一郎（パナソニックEWネットワークス）	
10:10	レーザ加工技術の進展とAM技術への期待（仮題）	塚本雅裕,佐藤雄二（大阪大学）	
11:10	レーザ微細加工技術への挑戦 -　40年の歩みと未来への展望 -	杉岡幸次（理化学研究所）	
	昼食休憩　（12:10-13:10）		
	会議室2：ショートプレゼンテーション　　会議室１：ポスタープレゼンテーション　テーブルトップ展示　カタログ展示		
13:10～	**ポスターショートプレゼンテーション(各2分間，ホール) + ポスタープレゼンテーション**	座長：（）	
	会議室2		会議室3
8A1	**DED方式による金属３Ｄプリンティング技術**	座長：山下順広（福井大学）	**8B1　次世代レーザ加工の新展開** 座長：橋田昌樹（東海大学）
15:30	DED技術の基礎と産業応用 ― 表面改質・補修から金属3D造形まで	後藤光宏（富士高周波工業）	15:30 第５世代重粒子線がん治療「量子メス」のためのレーザ駆動イオン入射器の開発　近藤公伯（量子科学技術研究開発機構）
16:00	精密DED技術の紹介と超硬皮膜形成への取り組み	左今佑（村谷機械製作所）	16:00 高強度レーザー・ナノ構造標的相互作用による準定常強磁場生成とその応用展開　松井隆太郎（核融合科学研究所）
16:30	コンビナトリアル・レーザーDEDによる新規合金材料探索とマテリアル・プロセス・インフォマティクス（仮題）	廣瀬伸吾（産業技術総合研究所）	16:30 次世代レーザー加工によるダイヤモンドNV中心の高効率形成 – パルス幅と偏光の役割 –　下間靖彦（京都大学）
17:00	指向性エネルギー堆積法を用いた積層造形におけるヘテロ凝固核粒子添加による組織制御	渡辺義見（名古屋工業大学）	17:00 斜め入射ダブルパルスによるレーザ微細周期構造の電磁粒子コードを用いた形成シミュレーション　坂上仁志（核融合科学研究所）
17:30	終了		17:30 終了
	18:00～ 懇親会（大阪大学 クルール）		

第105回レーザ加工学会講演会　予告プログラム

2日目　　2026年12月9日（水） 大阪大学 コンベンションセンター

会議室2			会議室３		
9A1	**次世代熱加工のためのレーザ光源**	座長：安岡 知道（古河電気工業）	**9B1**	**表面機能付与加工**	座長：楠本利行（ ライアグ・テック）
10:00	青色レーザの高輝度化とその加工事例	小暮 凌馬（古河電気工業）	10:00	GH z -burstによるガラス表面の撥水性付与と応用（仮題）	玉木 隆幸（奈良工業高等専門学校）
10:30	温度コントロール機能付きガルバノスキャナ光学系による金属の加熱及び樹脂接合	塩見 亮祐（トルンプ）	10:30	異種材への超短パルスレーザ照射による表面機能創製	山室 悠香（産業技術総合研究所）
11:00	高出力・高輝度ダイレクト半導体レーザの最新動向と加工例	武田 進（レーザーライン）	11:00	メガワット級光渦アレイの生成とキラルナノ構造形成	中田 芳樹（大阪大学）
11:30	スマートレーザ加工を実現するJPTの発振・制御・モニタリング技術	太田 道春（JPTジャパン）	11:30	表面テクスチャリング技術による低損失と高密封性能を両立したメカニカルシールの開発と実用化	徳永雄一郎（イーグル工業）
昼食休憩　(12:00-13:00)					
会議室2			会議室３		
9A2	**レーザ溶接の基礎と新展開**	座長：冨田 海（JFEスチール）	**9B2**	**半導体産業に寄与するレーザ微細加工**	座長：栗田典夫（浜松ホトニクス）
13:00	【ベストオーサー賞受賞記念講演】 2波長重畳ハイブリッドレーザを用いた純銅のキーホール型溶接における青色半導体レーザ先行加熱の効果	藤尾駿平（古河電気工業）	13:00	半導体製造用DUV～EUV光源開発とその応用の現状	溝口 計（九州大学）
13:30	高出力半導体レーザを用いた加工事例の紹介	丸本 啓太（広島大学）	13:30	データ駆動型材料研究からみたレーザ加工と今後の展望	知京 豊裕（NIMS）
14:00	曲線TWBラダーフレーム量産化を実現するレーザ・アークハイブリッド溶接を用いた生産システムの開発	内山 博史（トヨタ自動車）	14:00	半導体製造工程に貢献するレーザプロセス	大川 裕樹（ＴＯＷＡレーザーフロント）
14:30	高出力レーザを用いた銅溶接と熱放射モニタリング統合したレーザ溶接システムの開発	菊地 俊文（タマリ工業）	14:30	超短パルスレーザー加工機の開発 －「LSPシリーズ」の特徴および脆性材および高硬度材の加工事例－	小河 誉典（ソディック）
コーヒーブレイク　(15:00～15:30)			コーヒーブレイク　(15:00～15:30)		
会議室2			会議室３		
9A3	**PBF方式による金属３Dプリンティング技術**	座長：山口貴（金沢大学）	**9B3**	**新たな光源を用いたレーザプロセス**	座長：古田啓介（三菱電機）
15:30	【ベストオーサー賞受賞講演】 ガスタービン高温部品への適用に向けたレーザ積層造形Ni 基耐熱材料の特性向上	種池 正樹（三菱重工業）	15:30	先端レーザ加工装置における微細加工技術・制御技術	林 優也 (レーザーシステム)
16:00	複合粉末を用いたレーザ積層造形体の高機能化	野村 直之（東北大学）	16:00	ウォータジェットガイドレーザ加工の科学的メカニズムの探求と先進材料加工への展開	高橋 哲（東京大学）
16:30	樹脂粉末を用いたPBFによる宇宙戦略に関するご講演（仮題）	小池 綾（慶応大学）	16:30	少量の加工結果データとAI技術を活用したCWレーザ照射時のスパッタ発生状況予測	楠本利行 （ライアグ・テック）
17:00	コンパクトPBF装置を用いたNi基MMC積層体の製作	江面 篤志（中央大学）	17:00	Heフリー短パルスCO2レーザーの開発と樹脂フィルムの加工	宇野 和行 （山梨大学）
17:30	終了				

※ 時間，内容に一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい.